

氧化爐管(1-1)考試注意事項：

- (1) 該背的數字或注意事項不可實際去看爐管本身的設定值或操作手冊，違者視同作弊，於 2 個星期後才可再考。
- (2) 錯 3 個以內(含)始可通過考試，若沒通過需隔一個星期再考一次；若錯的地方含有者，則下星期約時間再考一次。
- (3) 若應考者態度不佳或回答試題時硬拗，於 3 個星期後再約時間考試。
- (4) 在約定時間超過 5 分鐘未來考試，則隔一星期再約時間考，若當天不能如期考試，需前一天取消。
- (5) 有任何問題請找自強基金會半導體光電研究室 張營煌，電話 03-5715131-4026。

什麼類型的晶片不可進入爐管？（經深蝕刻、含有金屬或含有機物的晶片）

機台氧氣壓力？APCVD 氧氣壓力？

機台氫氣壓力？鋼瓶一次壓、二次壓力？

氮氣壓力、流量？

晶片是否有標準清洗？

標準清洗注意事項？

標準清洗步驟？

是否檢查爐口與支撐架之距離？

是否檢查爐管溫度在 800 ？

是否填寫操作記錄簿？

點火前打開氫氣

點火測試是否熟練、檢查流量、最後要停 30 秒再關？

幾次未點燃須通知設備工程師？

Load Out 是否熟練及按照步驟（拉出 3-5 公分再自動拉出）？

晶片放置注意事項？

Load In 是否熟練，蓋上爐門注意事項？

關閉推進器電源？

溫度對應刻度？看哪一本？

操作升溫器是否熟練、正確？

手動升溫？

升溫至 1100 時是否調整左右溫度？

長濕氧 5000A、10000A 設定？

RUN 濕氧時沒氧氣處理步驟？

跳至最後一個步驟，通氧氣 30 秒，關閉製程面版

關氫氣

降溫至 800

通知設備或廠務工程師

RUN 濕氧時要注意壓力及流量是否正常？

長乾氧 1000A 設定？

RUN 完，關閉製程面版、氫氣開關

降溫至 800

晶舟拉不出時，處理方式？

填寫操作記錄簿

設備故障時處理步驟？可否自行動手修理？

Nanospac 操作是否熟練？

日後在操作時若有忘記的地方，請看操作手冊，不要自己試。